

合肥颀中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-013

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参加 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演/反路演活动 ☒ 电话会议
来访单位名称	国寿养老、东方财富
时间	2025 年 11 月 26 日
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强 证券事务代表：陈颖
投资者关系活动主要内容介绍	1. 问：公司对非显示业务的未来发展布局？ 答：公司的非显示主要以电源管理芯片、射频前端芯片（功率放大器、射频开关、低噪放等）为主，少部分为 MCU（微控制单元）、MEMS（微机电系统）等其他类型芯片，可广泛用于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游应用领域。公司以稳中求进的策略，基于现有 bumping 客户，延伸我们的服务范围到 package-level 的封装测试服务，可降低现有客户需要再委外封测的成本；后续再通过先进功率及倒装芯片封测技术改造项目导入 BGBM/FSM、Cu Clip、覆晶封装 FCQFN/FCLGA 制程，进一步完善非显示类芯片封测全制程产能，并在现有电源管理芯片、射频前端芯片的基础上，新增功率器件封装布局，提升公司在非显示类芯片封测领域的市场竞争力。 2. 问：公司境外的主要客户？ 答：公司境外的主要客户为联咏、瑞鼎、敦泰、谱瑞、OMNIVISION TOUCH AND DISPLAY 等。 3. 问：2025 年第一季度公司净利润较上年同期有所下降的原因？ 答：主要原因如下：（1）合肥厂因处于产能爬坡期，当期相应的折旧及人工费用等固定成本及费用较上年同期有所增长；（2）在高效散热、高结合力等高性能芯片、车规级高稳定性铜柱芯片封装的研究、高刷新率及高分辨率显示驱动芯片的测试研究

	等先进集成电路封测领域，公司在继续扩充产能的同时持续加大研发投入，当期研发费用较上年同期有所增长；（3）为了吸引和留住优秀人才及核心骨干，公司实施限制性股票激励计划，当期相应摊销的股份支付费用较上年同期有所增长。 4. 问：顾邦作为股东对公司有什么影响吗？ 答：顾邦科技作为公司间接股东，自 2011 年以来便未实际参与公司的日常经营管理。公司与顾邦科技在资产、人员、业务、财务和机构等方面都相互独立。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 27 日